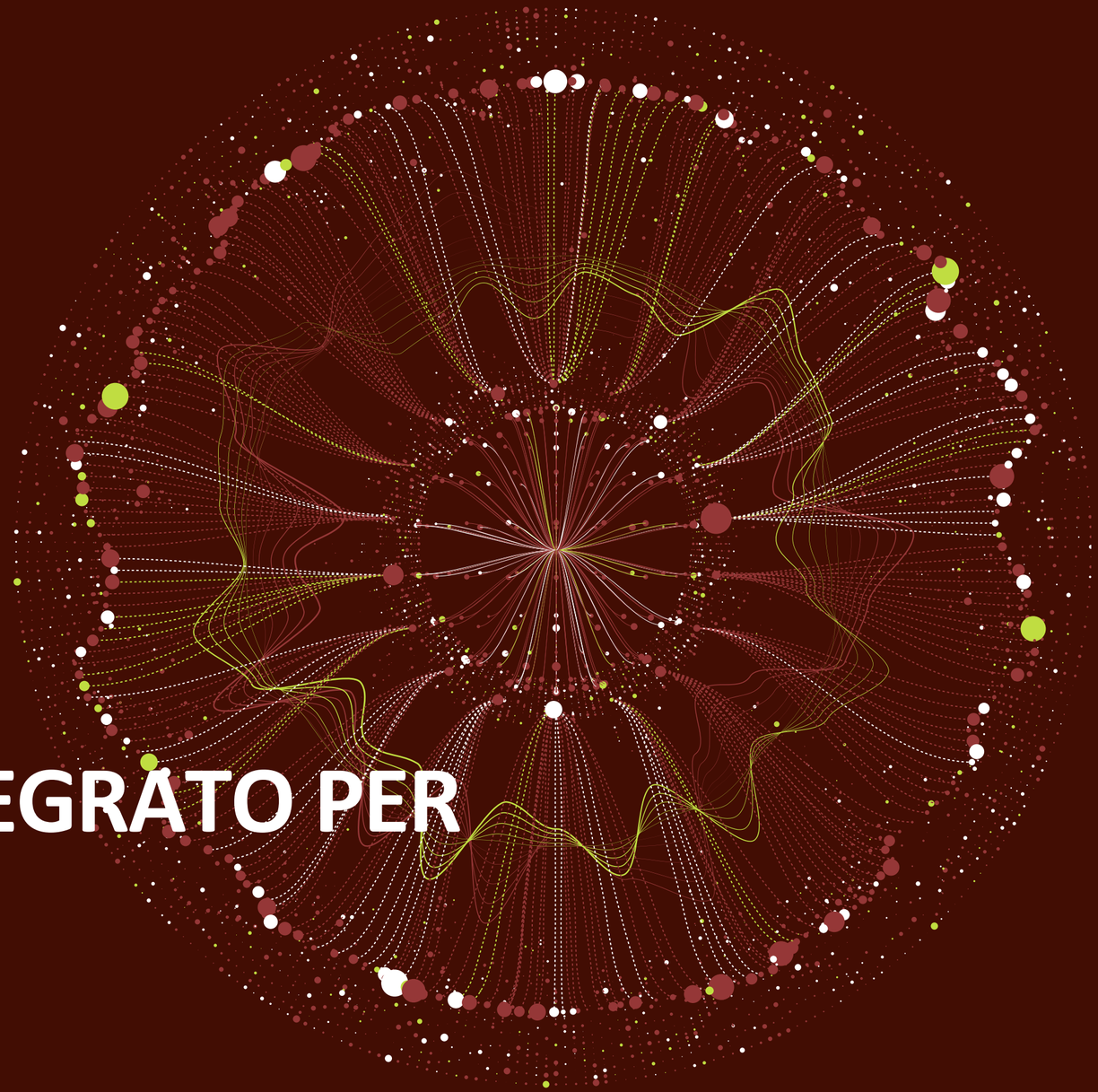
LINEA PILOTA · CASO D'USO ADVANCED MANUFACTURING

DISSIPATORE TERMICO INTEGRATO PER ELETTRONICA

Stampa 3D di dissipatori integrati nel PCB



DISSIPATORE TERMICO INTEGRATO PER ELETTRONICA

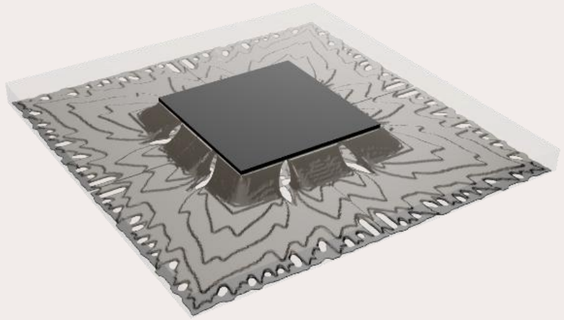
LA SOLUZIONE

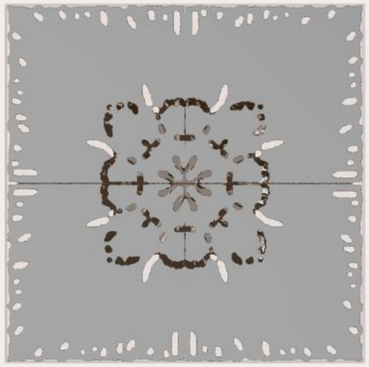
Ottimizzazione termofluidodinamica + AME

Dissipatore termico per componenti elettronici che generano hotspot e zone calde.

Ottimizzazione CFD e progettazione generativa di dissipatori integrati direttamente nel PCB mediante Additive Manufacturing Electronics (AME).

Obiettivo: ridurre la temperatura di giunzione dei componenti critici e migliorare affidabilità e prestazioni.





VANTAGGI

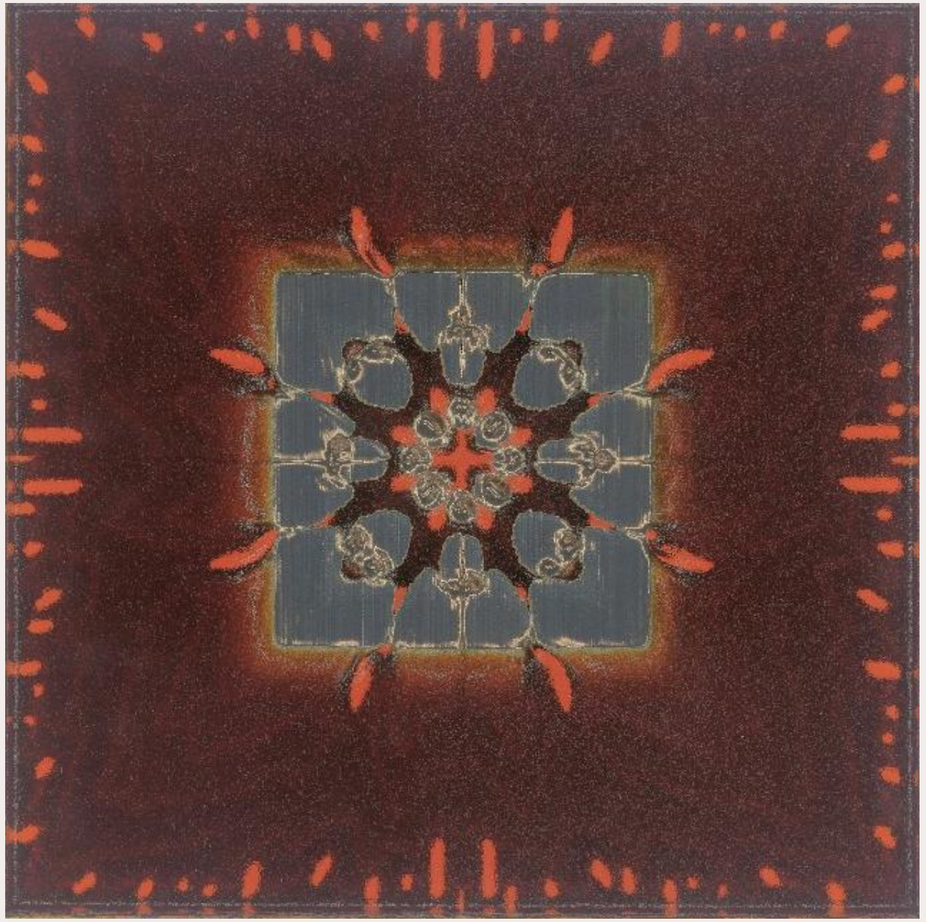
- Ottimizzazione termofluidodinamica della struttura conduttiva.
- La stampa 3D di elettronica consente l'integrazione di strutture dissipative complesse direttamente all'interno del PCB, superando i vincoli produttivi delle tecnologie tradizionali.
- L'integrazione del dissipatore riduce ingombri e interfacce termiche migliorando l'efficienza di raffreddamento.

TECNOLOGIE

Ottimizzazione termofluidodinamica | Design for Additive | Additive Manufacturing | AME | Elettronica | Dissipatore integrato

DISSIPATORE TERMICO INTEGRATO PER ELETTRONICA

Prototipo stampato 3D di dissipatori termici





DISSIPATORE TERMICO INTEGRATO PER ELETTRONICA

Simulazioni termiche dei dissipatori ottimizzati

